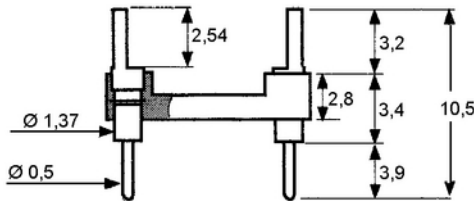


### Technische Daten / Technical Data

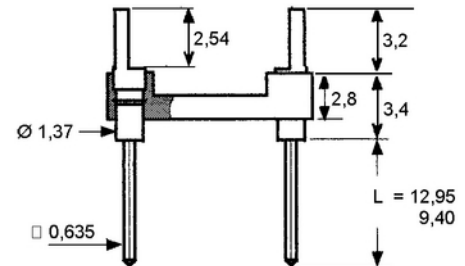
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to plating options, over Ni
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV <sub>RMS</sub>
Test Voltage	1kV <sub>RMS</sub>
Nennspannung	100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub>
Voltage Rating	100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering



© W+P PRODUCTS

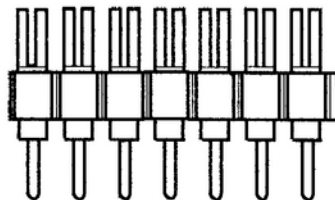
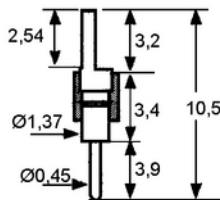


**IC-Fassung Serie 175**  
**IC-Socket Series 175**

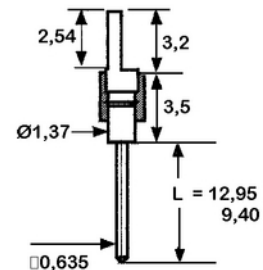


**Wire-Wrap Anschluß**  
**Wire-Wrap Type**

**Einlötlanschluß**  
**Solder Type**



**IC-Leiste Serie 188**  
**IC-Strip Series 188**



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>DIP*</b>	<b>Terminals*</b>	<b>Plating*</b>
<b>175</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
175 IC-Fassungen IC Sockets	06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 28 20 22 24 28 32 10 24 28 32 36 40 42 48 50 52 50 52 64	3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm 9 22,86mm	10 L=3,90, Ø0,50mm 20 L=9,40, Sq0,635mm WireWrap 30 L=12,95, Sq0,635mm WireWrap	10 Feder vergoldet 0,25µm 10µ" gold plated clip 30 Feder vergoldet 0,75µm 30µ" gold plated clip 50 Verzinkt Tin plated
<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Rows*</b>	<b>Terminals*</b>	<b>Plating*</b>
<b>188</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
188 IC-Leisten IC Headers	01-64 Einreihig Single row 02-64 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	10 L=6,60, Ø0,50mm 20 L=9,40, Sq0,635mm WireWrap 30 L=12,95, Sq0,635mm WireWrap	10 Feder vergoldet 0,25µm 10µ" gold plated clip 30 Feder vergoldet 0,75µm 30µ" gold plated clip 50 Verzinkt Tin plated

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wppro.com  
WEBSITE www.wppro.com

## Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



### Reflow-Löttempfehlung

*Reflow Soldering Recommendation*

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).*

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

